

10/810,639
July 2, 2004

日本国特許庁

JAPAN PATENT OFFICE

McDermott Will & Emery LLP

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 2004年 2月26日
Date of Application:

出願番号 特願2004-051051
Application Number:

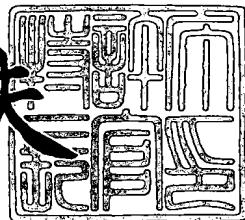
[ST. 10/C] : [JP2004-051051]

出願人 三洋電機株式会社
Applicant(s):

2004年 4月19日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今井康夫



出証番号 出証特2004-3032922

【書類名】 特許願
【整理番号】 NPA1040055
【提出日】 平成16年 2月26日
【あて先】 特許庁長官殿
【国際特許分類】 H01G 9/15
【発明者】
 【住所又は居所】 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三洋電機株式会社内
 【氏名】 高谷 和宏
【発明者】
 【住所又は居所】 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三洋電機株式会社内
 【氏名】 矢野 瞳
【発明者】
 【住所又は居所】 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三洋電機株式会社内
 【氏名】 木本 衛
【特許出願人】
 【識別番号】 000001889
 【氏名又は名称】 三洋電機株式会社
【代理人】
 【識別番号】 100098305
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 福島 祥人
 【電話番号】 06-6330-5625
【先の出願に基づく優先権主張】
 【出願番号】 特願2003- 97306
 【出願日】 平成15年 3月31日
【手数料の表示】
 【予納台帳番号】 032920
 【納付金額】 21,000円
【提出物件の目録】
 【物件名】 特許請求の範囲 1
 【物件名】 明細書 1
 【物件名】 図面 1
 【物件名】 要約書 1
 【包括委任状番号】 0006012

【書類名】特許請求の範囲**【請求項1】**

金属からなる陽極の表面に前記金属の酸化物からなる誘電体層が形成され、前記誘電体層の表面に金属層が形成されたことを特徴とする固体電解コンデンサ。

【請求項2】

前記金属層は金属粒子からなることを特徴とする請求項1記載の固体電解コンデンサ。

【請求項3】

前記金属粒子の平均粒径は $0.05\mu m$ 以下であることを特徴とする請求項2記載の固体電解コンデンサ。

【請求項4】

前記金属粒子の平均粒径は $0.01\mu m$ 以上であることを特徴とする請求項2または3記載の固体電解コンデンサ。

【請求項5】

前記金属粒子は、銀、金および白金よりなる群から選択された1種または2種以上の金属を含むことを特徴とする請求項2~4のいずれかに記載の固体電解コンデンサ。

【請求項6】

前記金属層は、保護コロイドを含むことを特徴とする請求項1~5のいずれかに記載の固体電解コンデンサ。

【請求項7】

前記金属層は、金属めっき層からなることを特徴とする請求項1記載の固体電解コンデンサ。

【請求項8】

前記陽極は、タンタル、アルミニウム、ニオブおよびチタンよりなる群より選択された1種または2種以上の金属を含むことを特徴とする請求項1~7のいずれかに記載の固体電解コンデンサ。

【請求項9】

金属からなる陽極の表面に前記金属の酸化物からなる誘電体層を形成し、前記誘電体層の表面に金属層を形成することを特徴とする固体電解コンデンサの製造方法。

【請求項10】

前記金属層を金属粒子により形成することを特徴とする請求項9記載の固体電解コンデンサの製造方法。

【請求項11】

前記金属粒子の平均粒径は $0.05\mu m$ 以下であることを特徴とする請求項10記載の固体電解コンデンサの製造方法。

【請求項12】

前記金属粒子の平均粒径は $0.01\mu m$ 以上であることを特徴とする請求項10または11記載の固体電解コンデンサの製造方法。

【請求項13】

前記誘電体層の表面に前記金属粒子を含む金属ペーストを塗布した後に前記金属ペーストを $150^{\circ}C$ 以上の温度で乾燥させることにより前記金属層を形成することを特徴とする請求項10~12のいずれかに記載の固体電解コンデンサの製造方法。

【請求項14】

有機溶媒中に前記金属粒子および保護コロイドを混合することにより金属ペーストを作製し、前記金属ペーストを前記誘電体層の表面に塗布することにより前記金属層を形成することを特徴とする請求項10~13のいずれかに記載の固体電解コンデンサの製造方法。

【請求項15】

前記金属層を金属めっきにより形成することを特徴とする請求項9記載の固体電解コンデンサの製造方法。

【書類名】明細書

【発明の名称】固体電解コンデンサおよびその製造方法

【技術分野】

【0001】

本発明は、固体電解コンデンサおよびその製造方法に関する。

【背景技術】

【0002】

近年、パーソナルコンピュータ等の電子機器の高周波数化により瞬時に電子回路に電流を供給する必要があるため、高周波領域で等価直列抵抗（以下、ESRと呼ぶ）の値が小さい固体電解コンデンサの開発が望まれている。

【0003】

ここで、ESRは、誘電体損失、電解質の比抵抗および電解質と陰極との接触抵抗の和からなる。高周波領域では、電解質の比抵抗および電解質と陰極との接触抵抗が支配的になる。

【0004】

一般的に、固体電解コンデンサは、上記金属からなる陽極を酸化して形成した誘電体層表面に二酸化マンガン等の導電性材料を密着させて陰極層を形成したものが用いられてきた。

【0005】

しかしながら、二酸化マンガンの導電率が低いので、電解質としてポリピロール、ポリチオフェン等の導電性高分子材料を用いた固体電解コンデンサが開発されている（例えば、特許文献1参照）。

【特許文献1】特開昭63-173313号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0006】

上記のように、固体電解コンデンサのESRは、主に電解質の比抵抗に依存する。しかしながら、電解質として用いる上記のポリピロール、ポリチオフェン等の導電性高分子材料の導電率は、半導体程度であり、金属に比べて3桁程度低い。例えば、ポリピロールの導電率は $10 \sim 10^2 S \cdot cm^{-1}$ である。そのため、高周波領域におけるESRの低減を図ることが困難であった。

【0007】

本発明の目的は、ESRが低減された固体電解コンデンサおよびその製造方法を提供することである。

【課題を解決するための手段】

【0008】

第1の発明に係る固体電解コンデンサは、金属からなる陽極の表面に金属の酸化物からなる誘電体層が形成され、誘電体層の表面に金属層が形成された構造を有するものである。

【0009】

本発明に係る固体電解コンデンサにおいては、誘電体層の表面に金属層を形成することにより、導電性の高い電解質を得ることができる。その結果、高周波領域での等価直列抵抗が低減される。

【0010】

金属層は金属粒子からなってもよい。この場合、より導電性の高い電解質を得ることができる。その結果、高周波領域での等価直列抵抗がより低減される。

【0011】

金属粒子の平均粒径は $0.05 \mu m$ 以下であることが好ましい。それにより、金属層中の金属粒子が誘電体層の表面に均一かつ緻密に形成される。その結果、高周波領域での等価直列抵抗が低減される。

【0012】

金属粒子の平均粒径は $0.01\mu m$ 以上であることが好ましい。それにより、金属粒子間の界面の増加による導電性の低下が生じない。その結果、高周波領域での等価直列抵抗が低減される。

【0013】

金属粒子は、銀、金および白金よりなる群から選択された1種または2種以上の金属を含むことが好ましい。

【0014】

この場合、銀、金および白金は高い導電率を有するので、金属層の導電率が高くなる。その結果、高周波領域での等価直列抵抗が低減される。

【0015】

金属層は、保護コロイドを含んでもよい。この場合、金属ペーストの作製時に金属粒子が二次凝集を起こすことが防止される。それにより、金属ペースト中に金属粒子が均一に分散するため、誘電体層の表面が微細な金属粒子で均一に被覆される。その結果、高周波領域での等価直列抵抗がより低減される。

【0016】

金属層は、金属めっき層からなってもよい。この場合、より導電性の高い電解質を得ることができる。その結果、高周波領域での等価直列抵抗がより低減される。

【0017】

陽極は、タンタル、アルミニウム、ニオブおよびチタンよりなる群より選択された1種または2種以上の金属を含むことが好ましい。タンタル、アルミニウム、ニオブおよびチタンの酸化物は比誘電率が高い。それにより、小型で大きな静電容量を得ることができる。

【0018】

第2の発明に係る固体電解コンデンサの製造方法は、金属からなる陽極の表面に金属の酸化物からなる誘電体層を形成し、誘電体層の表面に金属層を形成するものである。

【0019】

本発明に係る固体電解コンデンサの製造方法によれば、誘電体層の表面に金属層を形成することにより、導電性の高い電解質を得ることができる。その結果、高周波領域での等価直列抵抗が低減された固体電解コンデンサが得られる。

【0020】

金属層を金属粒子により形成してもよい。この場合、より導電性の高い電解質を得ることができる。その結果、高周波領域での等価直列抵抗がより低減される。

【0021】

金属粒子の平均粒径は $0.05\mu m$ 以下であることが好ましい。それにより、金属層中の金属粒子が誘電体層の表面に均一かつ緻密に形成される。その結果、高周波領域での等価直列抵抗が低減される。

【0022】

金属粒子の平均粒径は $0.01\mu m$ 以上であることが好ましい。それにより、金属粒子間の界面の増加による導電性の低下が生じない。その結果、高周波領域での等価直列抵抗が低減される。

【0023】

誘電体層の表面に金属粒子を含む金属ペーストを塗布した後に金属ペーストを $150^{\circ}C$ 以上の温度で乾燥させることにより金属層を形成することが好ましい。

【0024】

それにより、誘電体層と金属層との接触抵抗がより小さくなり、高周波領域での等価直列抵抗がより低減される。

【0025】

有機溶媒中に金属粒子および保護コロイドを混合することにより金属ペースト作製し、金属ペーストを誘電体層の表面に塗布することにより金属層を形成することが好ましい。

【0026】

この場合、保護コロイドにより有機溶媒中の金属粒子が二次凝集を起こすことが防止される。それにより、金属ペースト中に金属粒子が均一に分散するため、誘電体層と金属層との接触抵抗がより小さくなる。その結果、高周波領域での等価直列抵抗がより低減される。

【0027】

金属層を金属めつきにより形成してもよい。この場合、より導電性の高い電解質を得ることができる。その結果、高周波領域での等価直列抵抗がより低減される。

【発明の効果】**【0028】**

本発明によれば、導電性の高い電解質を得ることができる。その結果、高周波領域での等価直列抵抗が低減される。

【発明を実施するための最良の形態】**【0029】****(第1の実施の形態)**

以下、本発明の第1の実施の形態に係る固体電解コンデンサおよびその製造方法について説明する。

【0030】

図1は本発明の実施の形態に係る固体電解コンデンサの構造図である。

【0031】

図1に示すように、固体電解コンデンサは、陽極2の表面に、誘電体層3および金属層4が順に形成された構造を有している。

【0032】

陽極2には陽極端子1が接続され、金属層4には導電性接着剤8を介して陰極端子5が接続されている。また、陽極端子1および陰極端子5の端部が外部に引き出されるようにモールド外装樹脂9が形成されている。

【0033】

陽極2は、タンタル粒子の多孔質焼結体からなる。タンタル粒子の多孔質焼結体は大きな表面積を有するため、大容量化が可能となる。なお、陽極2は、タンタルに限らず、アルミニウム、ニオブまたはチタン等の他の弁作用金属からなる金属粒子により形成されてもよく、タンタル、アルミニウム、ニオブまたはチタン等の金属粒子のうち2種類以上を含んでもよい。

【0034】

また、誘電体層3は、陽極2の表面を例えればリン酸水溶液中で陽極酸化させることにより形成される誘電体酸化膜からなる。本実施の形態では、誘電体層3は酸化タンタルからなる。陽極2がアルミニウム、ニオブまたはチタン等の他の金属粒子の多孔質焼結体からなる場合には、誘電体層3は、酸化アルミニウム、酸化ニオブまたは酸化チタン等の酸化物からなる。

【0035】

金属層4は、銀粒子、保護コロイドおよび有機溶媒を混合することにより銀ペーストを作製し、誘電体層3の表面に塗布し、乾燥させることにより形成される。なお、金属層4の形成方法については、後述する。

【0036】

銀粒子の平均粒径は0.05μm以下であることが好ましい。それにより、金属層4中の銀粒子が誘電体層3の表面に均一かつ緻密に形成される。その結果、後述するように、高周波領域での等価直列抵抗が低減された固体電解コンデンサが得られる。

【0037】

ここで、平均粒径とは、粒子の粒度分布における累積分布曲線の累積値が50%になるときの粒子径をいう。

【0038】

また、銀粒子の平均粒径は $0.01\mu\text{m}$ 以上であることが好ましい。それにより、銀粒子間の界面の増加による導電性の低下が生じない。その結果、後述するように、高周波領域での等価直列抵抗が低減された固体電解コンデンサが得られる。したがって、平均粒径が $0.01\mu\text{m}$ 以上 $0.05\mu\text{m}$ 以下の銀粒子を用いることがより好ましい。

【0039】

コストの面から金属粒子として銀粒子を用いることが好ましいが、銀粒子の代わりに金粒子または白金粒子を用いてもよい。あるいは、銀粒子、金粒子および白金粒子のうち2種類以上の金属粒子を用いてもよい。

【0040】

次に、本発明の実施の形態に係る固体電解コンデンサの製造方法について説明する。

【0041】

まず、タンタル粒子の粉体を焼結させることにより多孔質焼結体からなる陽極2を形成する。この場合、タンタル粒子間が溶着する。なお、アルミニウム、ニオブまたはチタン等の他の金属粒子の粉体を用いてもよい。

【0042】

次に、陽極2をリン酸水溶液中で陽極酸化させることにより、陽極2の表面に誘電体層3を形成する。

【0043】

一方、平均粒径が $0.05\mu\text{m}$ 以下の銀粒子および保護コロイドを所定の重量比で混合したものと有機溶媒とを所定の重量比で混合することにより、銀ペーストを作製する。

【0044】

ここで、保護コロイドとは、疎水コロイドの電解質に対する安定性を増すために加える親水コロイドをいう（岩波 理化学辞典 第5版、p1300）。保護コロイドを用いることにより、銀粒子が二次凝集を起こすことなく有機溶媒中に均一に分散する。

【0045】

保護コロイドとしては、ポリエチレンイミン、またはポリエチレンイミンの酸化塩を用いることができる。また、保護コロイドとして、エポキシ化合物にアミン化合物とカルボキシル基含有プレポリマとを反応させた化合物、ポリウレタンおよびポリウレアよりなる主鎖に複数の第3級アミノ基または塩基性環式窒素原子を有する基が鎖化した高分子等を用いてもよい。また、有機溶媒としては、エタノール等を用いることができる。

【0046】

続いて、上記の方法により作製された銀ペーストを誘電体層3上に塗布する。この場合、銀ペーストは多孔質焼結体の表面の誘電体層3間の隙間を埋めるように誘電体層3の表面に形成される。

【0047】

その後、銀ペーストを所定の温度で乾燥させることにより誘電体層3上に金属層4を形成する。乾燥温度は 150°C 以上であることが好ましい。それにより、金属層4の銀粒子を凝集させることができ、金属層4の導電性を高めることができる。その結果、高周波領域での等価直列抵抗がより低減される。

【0048】

続いて、金属層4に導電性接着剤8を介して陰極端子5を接続する。その後、陽極端子1および陰極端子5の端部が外部に引き出されるようにモールド外装樹脂9を形成する。以上のことにより、固体電解コンデンサが作製される。

【0049】

本実施の形態においては、誘電体層3上に銀粒子からなる金属層4を形成することにより、導電性の高い電解質を得ることができる。その結果、高周波領域でのESRが低減された固体電解コンデンサを得ることができる。

【0050】

また、銀ペーストに保護コロイドを混合することにより、銀ペーストの作製時に銀粒子が二次凝集を起こすことが防止される。それにより、銀ペースト中に銀粒子が均一に分散

するため、誘電体層3の表面を銀ペーストにより均一かつ緻密に被覆することができる。

【0051】

さらに、誘電体層3の表面に銀ペーストを塗布した後に銀ペーストを150℃以上の温度で乾燥させた場合、保護コロイドにより分散していた銀ペースト内の銀粒子が凝集する。それにより、金属層4の導電性を高めることができる。その結果、高周波領域でのESRがより低減される。

【0052】

なお、本実施の形態では、陽極2としてタンタル、アルミニウム、ニオブおよびチタン等の粉末焼結体を用いたが、これに限定されるものではなく、例えばこれらの金属の箔を用いてもよい。

【0053】

(第2の実施の形態)

以下、本発明の第2の実施の形態に係る固体電解コンデンサおよびその製造方法について説明する。

【0054】

本実施の形態に係る固体電解コンデンサが第1の実施の形態に係る固体電解コンデンサと異なる点は、以下に示す金属層4の構成および形成方法である。

【0055】

本実施の形態では、誘電体層3が形成された陽極2をアンモニア性硝酸銀水溶液に浸漬させ、ブドウ糖をさらに添加することにより、誘電体層3上に無電解めっきにより金属層4が形成される。なお、アンモニア性硝酸銀水溶液は、硝酸銀水溶液にアンモニア水を添加することにより生成される。

【0056】

本実施の形態においては、誘電体層3上に無電解めっきにより金属層4を形成することにより、導電性の高い電解質を得ることができる。その結果、高周波領域でのESRが低減された固体電解コンデンサを得ることができる。

【実施例】

【0057】

以下の実施例では、上記第1の実施の形態および第2の実施の形態に係る製造方法に従って図2に示す固体電解コンデンサ100を作製し、ESRを評価した。図2は実施例1～13で作製した固体電解コンデンサ100の模式図である。

【0058】

(実施例1～7)

本実施例では、上記第1の実施の形態に係る製造方法により固体電解コンデンサ100を以下のように作製し、ESRを評価した。

【0059】

まず、実施例1～7では、銀粒子の平均粒径をそれぞれ0.009μm、0.01μm、0.03μm、0.05μm、0.06μm、0.07μmおよび0.09μmとして、次の条件および方法で固体電解コンデンサ100を作製した。

【0060】

保護コロイドとしてポリエチレンイミンを用い、銀粒子とポリエチレンイミンとをそれぞれ70重量%および30重量%の割合で混合する。この混合物質と有機溶媒であるエタノールをそれぞれ60重量%および40重量%の割合で混合し、銀ペーストを作製した。

【0061】

次に、タンタル粒子の粉体を焼結させることにより多孔質焼結体からなる陽極2を形成し、陽極2をリン酸水溶液中で陽極酸化し、陽極2の表面に誘電体酸化膜からなる誘電体層3を形成した。

【0062】

続いて、上記の方法により作製した銀ペーストを誘電体層3の表面に塗布し、温度150℃で30分間乾燥させることにより金属層4を形成した。また、陽極2に陽極端子1を

接続し、金属層4に陰極端子5を接続した。

【0063】

(実施例8)

本実施例では、上記第2の実施の形態に係る製造方法により固体電解コンデンサ100を以下のように作製し、ESRを評価した。

【0064】

タンタル粒子の粉体を焼結させることにより多孔質焼結体からなる陽極2を形成し、陽極2をリン酸水溶液中で陽極酸化し、陽極2の表面に誘電体酸化膜からなる誘電体層3を形成した。

【0065】

続いて、誘電体層3が形成された陽極2をアンモニア性硝酸銀水溶液に浸漬させ、3重量%のブドウ糖をさらに添加することにより誘電体層3上に無電解めっきにより金属層4を形成した。なお、アンモニア性硝酸銀水溶液は、0.15mol/lの硝酸銀水溶液に3mol/lのアンモニア水を添加することにより生成される。

【0066】

また、陽極2に陽極端子1を接続し、金属層4に陰極端子5を接続した。

【0067】

(比較例)

図3は比較例で作製した固体電解コンデンサ101の模式図である。

【0068】

図3に示すように、比較例では、実施例3で作製した誘電体層3の表面に電解質4a、カーボン層6および銀層7を順に積層し、固体電解コンデンサ101を作製した。

【0069】

なお、本比較例における銀層7は、実施例3で作製した平均粒径0.03μmの銀粒子からなる銀ペーストをカーボン層6の表面に塗布することにより形成した。

【0070】

以下、比較例で作製した固体電解コンデンサ101の製造方法について説明する。

【0071】

まず、タンタル粒子の粉体を焼結させることにより多孔質焼結体からなる陽極2を形成した。

【0072】

次に、陽極2をリン酸水溶液中で陽極酸化し、陽極2の表面に誘電体酸化膜からなる誘電体層3を形成した。

【0073】

続いて、電解重合等によりポリピロールからなる電解質4aで誘電体層3の表面を被覆した。さらに、電解質4a上にカーボンペーストを塗布し、温度150℃で30分間乾燥させることによりカーボン層6を形成した。

【0074】

続いて、実施例3で作製した平均粒径0.03μmの銀粒子からなる銀ペーストをカーボン層6の表面に塗布し、温度150℃で30分間乾燥させることにより銀層7を形成した。また、陽極2に陽極端子1を接続し、銀層7に陰極端子5を接続した。以上の方法により、固体電解コンデンサ101を作製した。

【0075】

(評価)

実施例1～8の固体電解コンデンサ100および比較例の固体電解コンデンサ101について周波数100kHzにおけるESRをLCRメータを用いて測定した。

【0076】

実施例1～8の固体電解コンデンサ100および比較例の固体電解コンデンサ101のESRの測定結果を表1に示す。なお、表1においては、実施例1～8の固体電解コンデンサ100のESRの測定結果を比較例の固体電解コンデンサ101のESRの測定結果

を100として規格化し、規格化したE S Rの値を示している。

【0077】

【表1】

	銀粒子の平均粒径 (μm)	E S R
実施例1	0. 009	81
実施例2	0. 01	55
実施例3	0. 03	60
実施例4	0. 05	62
実施例5	0. 06	87
実施例6	0. 07	92
実施例7	0. 09	97
実施例8	—	53
比較例	0. 03	100

【0078】

実施例1～8では、E S Rの値は97以下となり、比較例のE S Rの値に比べ小さくなつた。したがつて、電解質として金属層4を用いることにより、ポリピロールからなる電解質4aを用いた場合に比べてE S Rの値が大幅に低減される。

【0079】

特に、無電解めつきにより形成された金属層4を用いた実施例8の固体電解コンデンサ100では、銀粒子からなる金属層4を用いた実施例1～7およびポリピロールからなる電解質4aを用いた比較例に比べ、E S Rの値が大幅に低減されることがわかつた。

【0080】

また、銀粒子の平均粒径が $0.01\mu\text{m} \sim 0.05\mu\text{m}$ の場合には、E S Rの値が55～62となり、比較例に比べ著しく小さくなることがわかつた。

【0081】

以上の結果から、無電解めつきにより形成された金属層4を用いることが最も好ましく、また、銀粒子による金属層4を用いる場合には、銀粒子の平均粒径は $0.01\mu\text{m} \sim 0.05\mu\text{m}$ が好ましい。

【0082】

(実施例9～13)

実施例9～13では、銀ペーストの乾燥温度を 140°C 、 145°C 、 150°C 、 160°C および 170°C とした点を除いて上記の実施例3と同じ条件および方法で固体電解コンデンサ100を作製した。なお、実施例11は上記の実施例3と同じである。

【0083】

(評価)

実施例9～13の固体電解コンデンサ100について周波数 100kHz におけるE S RをL C Rメータを用いて測定した。

【0084】

実施例9～13の固体電解コンデンサ100のE S Rの測定結果を表2に示す。なお、表2においては、実施例9～13の固体電解コンデンサ100のE S Rの測定結果を実施例9の固体電解コンデンサ100のE S Rの測定結果を100として規格化し、規格化したE S Rの値を示している。

【0085】

【表2】

	乾燥温度 (°C)	E S R
実施例 9	140	100
実施例 10	145	95
実施例 11	150	70
実施例 12	160	65
実施例 13	170	65

【0086】

実施例9および10では、E S Rの値はそれぞれ100および95となった。実施例11～13では、E S Rの値が65～70となり、実施例9および10に比べ著しく小さくなることがわかった。

【0087】

以上の結果から、銀ペーストの乾燥温度は150°C以上が好ましい。

【産業上の利用可能性】

【0088】

本発明は、固体電解コンデンサおよびその製造方法に利用することができる。

【図面の簡単な説明】

【0089】

【図1】本発明の実施の形態に係る固体電解コンデンサの構造図である。

【図2】実施例1～13で作製した固体電解コンデンサの模式図である。

【図3】比較例1で作製した固体電解コンデンサの模式図である。

【符号の説明】

【0090】

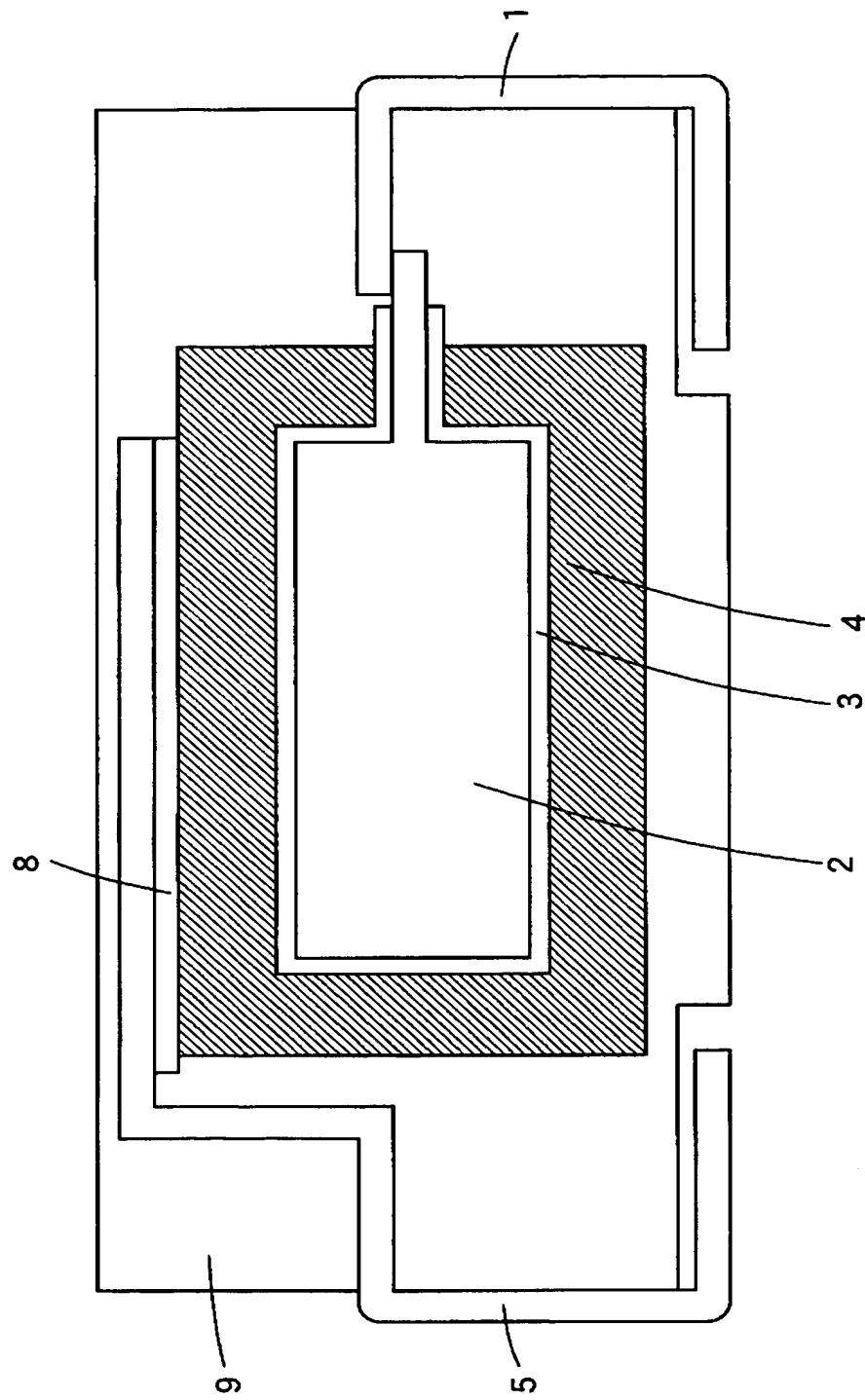
2 陽極

3 誘電体層

4 金属層

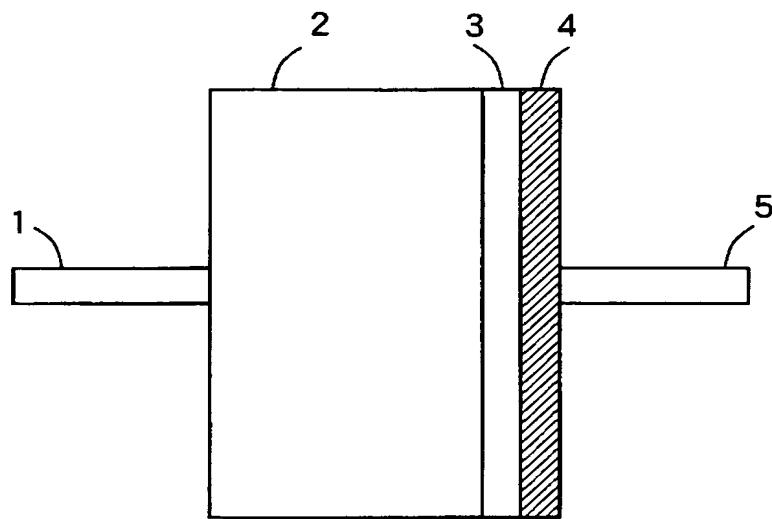
100 固体電解コンデンサ

【書類名】 図面
【図 1】



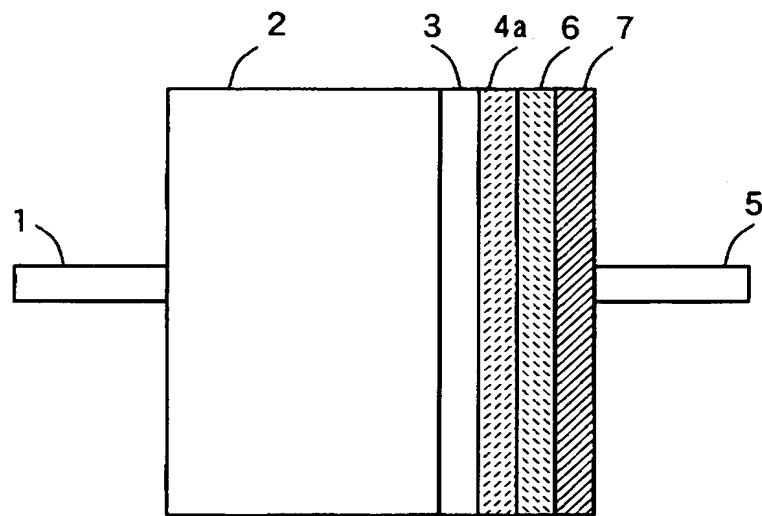
【図2】

100
↙



【図3】

101
↙



【書類名】要約書

【要約】

【課題】 E S R (等価直列抵抗) が低減された固体電解コンデンサおよびその製造方法を提供する。

【解決手段】 固体電解コンデンサは、陽極2の表面に、誘電体層3および金属層4が順に形成された構造を有している。陽極2は、タンタル粒子の多孔質焼結体からなる。また、誘電体層3は、陽極2の表面を例えばリン酸水溶液中で陽極酸化させることにより形成される誘電体酸化膜からなる。金属層4は、平均粒径が $0.05\mu m$ 以下の銀粒子、保護コロイドおよび有機溶媒を混合することにより銀ペーストを作製し、誘電体層3の表面に塗布し、 $150^{\circ}C$ 以上の温度で乾燥させることにより形成される。さらに、陽極2には陽極端子1が接続され、金属層4には導電性接着剤8を介して陰極端子5が接続されている。

【選択図】 図1

特願 2004-051051

出願人履歴情報

識別番号 [000001889]

1. 変更年月日 1993年10月20日

[変更理由] 住所変更

住 所 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号
氏 名 三洋電機株式会社